



Moldex3D 模流達人賽 – 模流創新，無限可能

活動說明與報名簡章

為幫助廣大的使用者更精進 Moldex3D CAE 模流分析軟體的應用技巧與方法，科盛科技特舉辦以「模流創新，無限可能」為主題的 Moldex3D 模流達人賽，希望廣邀 Moldex3D 的應用頂尖好手參賽，展現如何將 Moldex3D 的強大功能更靈活、更有創意的應用在各式產品設計與模具製造的挑戰中，同時分享使用 Moldex3D 的心得與技巧。

優勝作品將獲得優渥的獎項，並公開刊登於本競賽官方網站與國內外媒體，與全世界模流頂尖人士分享殊榮。誠摯邀請您的參與，並期待您不要錯過與各地高手過招的機會，展現您創新應用模流分析工具，創造無限可能的實戰力。

一、競賽主題

徵求以「模流創新，無限可能」為主題，運用 Moldex3D 模流分析軟體(任何模組/功能)進行新技術的研發、產品/模具設計、模具製造等與產品開發流程中各環節相關的改善與優化實務應用成果與成功案例。

二、參賽對象

分為學校組與企業組共 2 個競賽組別，參賽者可以團體的型式參賽，團隊最多為六人。

- 學校組：全國大專院校全體師生，皆可報名參加。
- 企業組：全國各企業單位或組織，皆可報名參加。

三、參賽作品要求

- 凡運用 Moldex3D 模流分析軟體各項模組/功能進行新技術的研發、產品/模具設計、模具製造或產品開發流程的改善與優化之應用經驗與案例分享等，皆符合本競賽的主題要求。
- 案例分享的呈現內容可為單一產品應用的深入案例分析或同一系列產品的整合式應用經驗分享。
- 企業組之參賽作品須為企業已經開發並投產上市的產品，企業組與學校組所繳交之作品皆需經過內部相關單位的審核與同意。

註：參與本次比賽的所有 CAD 模型與報告內容皆須為可公開，且保證無任何涉密問題。否則，後果將由參賽單位自行負責。同時，作品提交後，即視為授權於科盛科技股份有限公司，科盛科技有權使用於相關學術、推廣教育活動與使用者故事等，並且有複製、使用、編輯、改編等之權利。



四、獎勵方式

優勝作品評選分別以各組 (學校組、企業組)為競賽單位，從各組中各評選優秀得獎作品，並將於 2012 年 12 月 17 日公開得獎名單。所有得獎作品除可獲得以下的獎項外，獲獎單位的介紹與 Logo 將刊登於活動網站、電子報、或其他媒體(媒介)上。

學校組

第一名 (壹名)	獎金新台幣 20,000 元、獎牌乙面、 2013 蘇州 CMSA 大會會議費用免費名額 3 名 (價值新台幣 24,000 元)。
第二名 (壹名)	獎金新台幣 10,000 元、獎牌乙面、 2013 蘇州 CMSA 大會會議費用免費名額 2 名 (價值新台幣 16,000 元)。
第三名 (壹名)	獎金新台幣 5,000 元、獎牌乙面、 2013 蘇州 CMSA 大會會議費用免費名額 1 名 (價值新台幣 8,000 元)。
優勝獎 (數名)	獎狀乙紙、 2013 蘇州 CMSA 大會會議費用免費名額 1 名 (價值新台幣 8,000 元)。

企業組

第一名 (壹名)	獎金新台幣 30,000 元、獎牌乙面、 2013 蘇州 CMSA 大會會議費用免費名額 3 名 (價值新台幣 24,000 元)。
第二名 (壹名)	獎金新台幣 20,000 元、獎牌乙面、 2013 蘇州 CMSA 大會會議費用免費名額 2 名 (價值新台幣 16,000 元)。
第三名 (壹名)	獎金新台幣 10,000 元、獎牌乙面、 2013 蘇州 CMSA 大會會議費用免費名額 1 名 (價值新台幣 8,000 元)。
優勝獎 (數名)	獎狀乙紙、 2013 蘇州 CMSA 大會會議費用免費名額 1 名 (價值新台幣 8,000 元)。

五、評審遴選與評分項目

- 評審團由主辦單位及台灣區電腦輔助成型技術交流協會代表共同組成，共計 5~6 名。
評審團總召集人由主辦單位邀請擔任，負責主持評審會議。
- 評分項目
 - 創意表現：主題之創新意念與適切性。(20%)
 - 工具應用：Moldex3D 模流分析軟體各模組與功能應用的準確性與適當性。(30%)
 - 實用價值：附有模擬與實物之比對、產品開發流程改善之過程分享與建議。(40%)
 - 總體表現：簡報內容與說明影片之豐富性、創意性及展示效果。(10%)



六、活動流程與報名方式

報名	報名採用通訊方式，請於 2012 年 10 月 31 日前將報名表(附件一)傳真至 03-5600-198 或 email 至 helenliang@moldex3d.com ，主辦單位將進行資格審核並各別通知參賽資格符合與否 (符合資格者，將於通知 email 中收到參賽編號)。
作品繳交	<ol style="list-style-type: none"> 請於 2012 年 11 月 23 日前提交參賽作品，繳交作品須包含授權同意書(附件二)、CAD 模型、說明報告(PPT 格式)、說明影片(限長 10 分鐘，可接受 AVI、MPEG、QuickTime、Real 及 Windows Media 檔案)。逾時繳件則視同放棄，將失去參賽資格，收件後將交付評選單位進行評分。 說明報告中需包括研究背景起源介紹、模擬與實物對比照片、設計變更的構思與執行、設變分析結果與討論、產品開發流程改善過程介紹、價值與效益分析等 (請參閱說明報告範例)。
得獎公佈	得獎作品將於 2012 年 12 月 17 日公布於活動網頁。

七、作品提交

作品可以網路上傳或掛號郵寄。

網路上傳	<ol style="list-style-type: none"> 請傳送作品檔案至 ftp.moldex3d.com 的 Moldex3D_Innovation_Talent_Award 資料夾中。 資料夾名稱與檔案名稱須為參賽作品編號(主辦單位將於報名後通知參賽編號)，不能有空格及特殊符號。檔案上傳完成後，請務必電話或 E-mail 告知，並說明參賽單位及檔案名稱方能算完成上傳手續。
郵局郵寄	刻錄光碟(含電子文檔)及模型實物等可透過郵局掛號郵寄，郵寄地址為「302 新竹縣竹北市台元街 32 號 8 樓之 2 科盛科技股份有限公司 行銷企劃部 收」。作品需註記參賽者之單位名稱、姓名及聯絡方式。



八、注意事項

1. 得獎者若經查證不符合本競賽之參賽資格或個人資料填報不實者，主辦單位將有權取消其得獎資格，並追回獎金及獎項等。
2. 參賽者須保證對其參賽作品擁有完全充分的知識財產權，作品若涉及抄襲、仿冒、修改他人等侵犯著作權之不法行為，經由主辦單位查證一概取消其參賽資格，如獲獎則取消得獎資格並追回獎金及獎項，另如觸犯相關之法律責任，應由投稿者自行負責處理。
3. 投稿作品一律不予退件，請參賽者自行留存原稿備份。評審前若遇不可抗力之任何災變、意外等事故所造成之損毀，由主辦單位另行通知交付備份作品，對毀損之作品恕不負賠償之責。
4. 參賽作品之著作權等智慧財產權歸屬作者，主辦單位得有權使用於相關學術、推廣教育活動與使用者故事等，並且有複製、使用、編輯、改編等之權利。
5. 評審委員會視作品程度，可以「從缺」或更改(增或減)得獎名額。
6. 活動內容若有更改或修訂，請參考活動網站公告。

舉辦單位

主辦單位：科盛科技股份有限公司

協辦單位：台灣區電腦輔助成型技術交流協會

報名及作品繳件窗口

科盛科技股份有限公司

302 新竹縣竹北市台元街 32 號 8 樓之 2

行銷企劃部 梁小姐

(03) 5600-199 (分機 703)

helenliang@moldex3d.com



附件一

Moldex3D 模流達人賽 報名表

作品名稱		參賽編號	(主辦單位填寫)
參賽負責人及職稱		組別	<input type="checkbox"/> 學校組 <input type="checkbox"/> 企業組
參賽單位			
聯絡電話		電子郵件	
作品簡介			
<p>作品內容(限 3000 字以內)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 產品介紹 2. Moldex3D 模流分析軟體創意應用過程 3. 產品或工作流程改善歷程 4. 應用效益評估 5. 應用感想與建議 			
參賽單位及專案負責人簡介			
<ol style="list-style-type: none"> 1. 單位簡介 2. 參賽負責人簡介 			

註：投稿作品一律不予退件，請參賽者自行留存原稿備份。評審前若遇不可抗力之任何災變、意外等事故所造成之損毀，由主辦單位另行通知交付備份作品，對毀損之作品恕不負賠償之責。



附件二

Moldex3D 模流達人賽 授權同意書

本團隊報名參加「Moldex3D 模流達人賽」學校組 或 企業組 (請勾選)，同意本活動參賽辦法的各項內容規定，並授予科盛科技股份有限公司以下的相關權利：

本團隊同意並擔保以下條款：

1. 本團隊擁有完全權利與權限簽署並履行本同意書，且已取得簽署本同意書必要之第三者同意與授權。
2. 茲同意無償授權科盛科技股份有限公司，將本次比賽作品(含CAD模型與模流分析專案)等內容，得不限地域、時間與次數，透過網路公開傳輸，使用於相關學術、推廣教育活動、使用者故事等，並且有複製、使用、編輯、改編等之權利。
3. 本同意書為專屬授權。本人保證未侵害或抄襲他人之著作，且未曾參加其他競賽得獎，特此聲明。本作品作者若有違反上開情事，願被取消資格及敘獎；本人作品若有侵害他人權利或涉及違法，本人願負全部之賠償責任。若因此致科盛科技股份有限公司受有損害，並願負賠償責任。
4. 如違反本同意書各項規定，參賽人須自負法律責任，科盛科技股份有限公司並得要求參賽人返還全數獎金。
5. 作品及本同意書內容範圍內，因可歸責於申請人之事由致本主辦單位受有損害，參賽人應負賠償本主辦單位之責。

此致 科盛科技股份有限公司

立同意書人: (請親簽)

立同意書人: (請親簽)

立同意書人: (請親簽)

中 華 民 國 1 0 1 年 月 日